

高通与联芯科技成立瓴盛科技 主打中低端手机芯片组

瓴盛科技的成立将活跃中低端手机芯片市场，推动中国集成电路产业的长足发展。

本刊记者 | 刁兴玲



在移动互联网、物联网、云计算、大数据等的带动下，半导体产业呈现加速增长的发展趋势，尤其是在我国印发《国家集成电路产业发展推进纲要》、设立国家集成电路投资基金等重大战略部署的推动下，我国集成电路产业迎来重要发展机遇。

5月26日，北京建广资产管理有限公司（以下简称建广资产）、联芯科技有限公司（大唐电信科技股份有限公司下属子公司，以下简称联芯科技）、高通（中国）控股有限公司（美国高通技术公司下属子公司，以下简称高通）以及北京智路资产管理有限公司（以下简称智路资本）共同签署协议成立合资公司——瓴盛科技（贵州）有限公司（以下简称瓴盛科技）。

四方优势强强联合

瓴盛科技注册资本近30亿元，其中高通和联芯科技分别占注册资本的24.133%，建广资产占34.643%，智路资本占17.091%。

大唐电信在公告中指出，项目实施后，预计可实现投资收益约3.96亿元，营业外收入约2.76亿元，合计对公司产生收益约6.72亿元。

作为重要出资方，建广资产和智路资本长期致力于全球半导体产业的投资布局，成功完

成了多起国际半导体公司的投资并购。智路资本管理合伙人张元杰表示：“智路资本致力于为合资公司提供金融、产业资源以帮助其成长，我们期待此次合作将成为中美伙伴长期合作的基石。”

高通与中国的合作历史已超过20年，在3G/4G时代与中国的合作伙伴共同成长，与合作伙伴成功的合作历史也使得高通对新公司有更高的期待。美国高通技术公司执行副总裁兼QCT总裁克里斯蒂安诺·阿蒙表示：“瓴盛科技的成立将帮助我们扩展全新的细分市场，进一步展示了我们对促进中国移动通信产业发展的长期承诺。”

大唐电信副总裁、联芯科技总经理钱国良表示：“联芯科技自成立以来，一直致力于提供领先的移动终端芯片及解决方案。目前瓴盛科技注入的人员以联芯科技为主，后续高通以及建广资产和智路资本的人员也会加入。”

瓴盛科技将高通的先进技术、规模

和产品组合与联芯科技独有的研发能力以及在中国产业界的深厚资源，建广资产在中国金融行业的良好关系，以及智路资本的全球金融、产业生态链资源进行了结合，合作伙伴间的协同效应有利于推动本地技术创新。

促进中国集成电路长足发展

在产品布局方面，瓴盛科技主要聚焦消费类手机市场，希望通过合资提升产品竞争力，并有效整合公司资源，提高行业占有率和影响力，经营范围主要是与芯片组解决方案有关的设计、包装、测试、客户支持和销售，以及技术开发、技术许可、技术咨询、技术服务和软件开发。钱国良补充道，这次合作主要是面向手机市场提供芯片解决方案，公司初期定位在中低端手机芯片领域，主攻价格100美元左右的手机组细分市场。

在建广资产投资评审委员会主席李滨看来，目前瓴盛科技在移动终端芯片方面发力，但今后可以向IoT和汽车电子等其他领域延展。瓴盛科技的成立将更多解决方案带到大众手机市场，也为未来拓展物联网等新市场打下了基础。

据悉，本次合资项目始于2015年年底，基于高通和联芯科技两家公司的战略互补需求而成立，高通是全球领先的无线半导体厂商，在中高端市场拥有领先地位。一直以来低端市场被联发科和展讯占据，瓴盛科技的成立可以助力高通进军低端市场，而联芯科技借助合资公司的成立也将提升自身的综合实力。瓴盛科技的成立虽然会带来市场竞争，但更重要的是将活跃中低端手机芯片市场，推动中国集成电路产业的长足发展。

瓴盛科技将注册在贵州贵安新区，相关合作事项须经有关部门批准，预计合资公司将于今年晚些时候整合完毕。